

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2007 年 9 月 27 日 (27.09.2007)

PCT

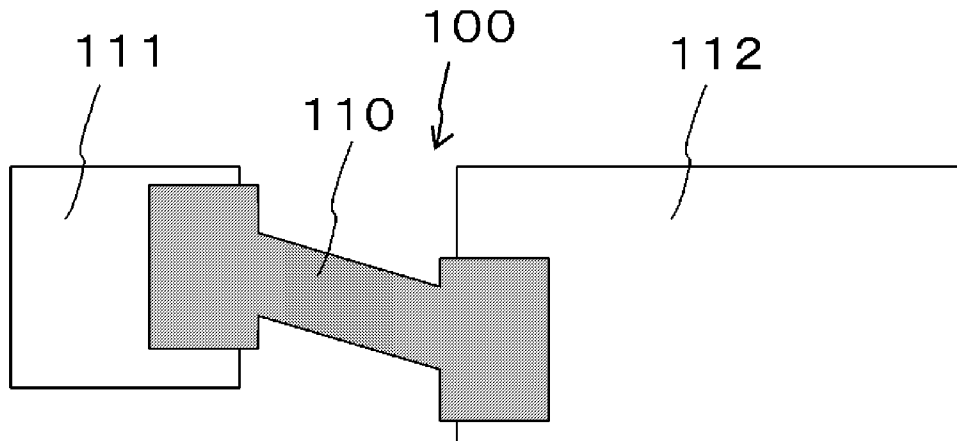
(10) 国際公開番号  
**WO 2007/108207 A1**

- (51) 国際特許分類:  
*H05K 1/14* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/000226
- (22) 国際出願日: 2007 年 3 月 14 日 (14.03.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2006-075896 2006 年 3 月 20 日 (20.03.2006) JP  
特願2006-144444 2006 年 5 月 24 日 (24.05.2006) JP  
特願2006-144453 2006 年 5 月 24 日 (24.05.2006) JP  
特願2006-207426 2006 年 7 月 31 日 (31.07.2006) JP  
特願2006-244292 2006 年 9 月 8 日 (08.09.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中馬敏秋 (CHUMA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒0118510 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下 2 7 - 4 秋田住友ベーク株式会社内 Akita (JP). 稲葉誠 (INABA, Makoto) [JP/JP]; 〒0118510 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下 2 7 - 4 秋田住友ベーク株式会社内 Akita (JP).
- (74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2 - 1 7 - 1 6 代官山 T K ビル 1 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

/ 続葉有 /

(54) Title: CIRCUIT BOARD AND CONNECTION SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 回路板および接続基板



(57) Abstract: Disclosed is a circuit board comprising first and second circuit substrates arranged separate from each other and respectively provided with a first and second conductor pad, and a connection substrate having first and second conductor posts respectively projecting from one side or the other side. The connection substrate is so arranged as to cover a part of the first and second circuit substrates, thereby bridging the first and second circuit substrates. The first conductor post and the first conductor pad, as well as the second conductor post and the second conductor pad are arranged opposite to each other respectively. In addition, the connection substrate has connecting portions which are formed by melting a metal coating layer formed in advance on the surface of at least one of the first conductor post and the first conductor pad, as well as on the surface of at least one of the second conductor post and the second conductor pad. In this circuit board, the first and second circuit substrates are electrically connected with the connection substrate through the connecting portions.

(57) 要約: 離間して配置された第一および第二の導体パッドが形成された第一および第二の回路基板と、一方の面側または他方の面側からそれぞれ突出する第一および第二の導体ポストを有する接続基板と

/ 続葉有 /



WO 2007/108207 A1



HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))
- 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

を備え、前記接続基板は、前記第一および第二の回路基板の一部を覆って橋渡しするように設けられ、前記第一の導体ポストと第一の導体パッドとが、および前記第二の導体ポストと第二の導体パッドとが、それぞれ対向するように配置され、前記第一の導体ポストまたは前記第一の導体パッドの少なくともいずれか一方の表面、および前記第二の導体ポストまたは前記第二の導体パッドの少なくともいずれか一方の表面に予め形成された金属被覆層が溶融されることにより形成される接続部を有し、前記第一および第二の回路基板と前記接続基板とが前記接続部を介して電氣的に接続している回路板が提供される。